

## 群聯電子 2024 年第二季 合併財報公告

本公司除揭露金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)<sup>註1</sup> 財務資訊外，另補充非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)<sup>註1-2</sup> 財務資訊(請參閱附表【補充資訊】)，其僅為補充而非替代資訊，且最終實際盈餘分配依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)的財務數據為準，提醒財務報告閱讀人特別注意。

### 2024 年第二季：金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)財務資訊

- 本季合併營業收入淨額為新台幣 158.95 億元，較前季減少 3.8%，較去年同期增加 58.8%。
- 本季合併毛利率為 34.9%，較前季增加 1.0 個百分點，較去年同期增加 2.4 個百分點。
- 本季合併營業利益為新台幣 19.97 億元，較前季增加 59.6%，較去年同期增加 178.3%。
- 本季合併本期淨利為新台幣 24.51 億元，每股盈餘為新台幣 11.97 元。

#### 合併營業收入

本公司 2024 年第二季之合併營業收入淨額為新台幣 158.95 億元，較前季減少 3.8%，較去年同期增加 58.8%。

#### 合併營業毛利及毛利率

本季合併營業毛利為新台幣 55.41 億元，較前季減少 1.2%，較去年同期增加 70.5%。本季合併毛利率為 34.9%，較前季增加 1.0 個百分點，較去年同期增加 2.4 個百分點，。

#### 合併營業費用

本季營業費用為新台幣 35.44 億元(佔營業收入 22.3%)，前一季營業費用為新台幣 43.55 億元(佔營業收入 26.4%)，去年同期營業費用為新台幣 25.33 億元(佔營業收入 25.3%)。

本季營業費用主要項目包括：

- ◆ 研究發展費用新台幣 28.53 億元(佔營業收入 18.0%)，低於前一季之新台幣 35.36 億元(佔營業收入 21.4%)，高於去年同期之新台幣 19.83 億元(佔營業收入 19.8%)。
- ◆ 推銷費用新台幣 4.00 億元(佔營業收入 2.5%)，低於前一季之新台幣 4.09 億元(佔營業收入 2.5%)，高於去年同期之新台幣 3.00 億元(佔營業收入 3.0%)。
- ◆ 管理費用新台幣 2.69 億元(佔營業收入 1.7%)，低於前一季之新台幣 4.49 億元(佔營業收入 2.7%)，高於去年同期之新台幣 1.90 億元(佔營業收入 1.9%)。

### 合併營業利益與營業利益率

本季營業利益為新台幣 19.97 億元，較前季增加 59.6%，較去年同期增加 178.3%。本季營業利益率為 12.6%，高於前一季之 7.6%；亦高於去年同期之 7.2%。

### 合併營業外收支與所得稅

本季營業外淨利益為新台幣 8.93 億元，佔營業收入 5.6%。主要係綜合認列採權益法投資利益、外幣兌換利益及認列透過損益按公允價值衡量之金融資產損益之結果。本季所得稅費用為新台幣 4.39 億元。

### 合併本期淨利、淨利率及每股盈餘

本季本期淨利為新台幣 24.51 億元，較前季增加 1.3%，較去年同期增加 456.2%。本季淨利率為 15.4%，高於前一季之 14.6%；高於去年同期之 4.4%；每股盈餘為新台幣 11.97 元，略低於前一季之 12.02 元；高於去年同期之 2.28 元。

### 合併現金及透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動

本季現金及按公允價值衡量之流動金融資產合計為新台幣 165.83 億元，佔總資產的 21.4%，前季現金及按公允價值衡量之流動金融資產合計為新台幣 152.62 億元，去年同期現金及按公允價值衡量之流動金融資產合計為新台幣 133.66 億元。按公允價值衡量之流動金融資產包含基金、國內上市櫃股票及衍生性商品等相關金融商品投資。

### 合併應收帳款

本季應收帳款淨額合計為新台幣 104.81 億元，平均應收帳款週轉天數 57 日(以本季平均應收帳款淨額及當期銷貨收入年化為計算基礎)，高於前季之 54 日；低於去年同期之 63 日。

### 合併存貨

本季存貨淨額合計為新台幣 304.11 億元，就本季存貨類型分析而言，本公司存貨應用於 Non-Retail 市場之占比大於 75%，其中包含控晶片約 17%、工業應用相關 15%、企業及伺服器應用相關約 23%、Embedded ODM 約 23%等，未來本公司將持續密切觀察市場需求與公司策略進行存貨調節。

平均存貨週轉天數 235 日(以本季平均存貨淨額及當期銷貨成本年化為計算基礎)，高於前季之 228 日；低於去年同期之 274 日。

### 現金股利配發

2024 年上半年度現金股利經董事會通過每股配發新台幣 13.19 元。

註 1. TIFRS 為 Taiwan-International Financial Reporting Standards 縮寫。

註 2. 非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)為金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)之補充而非替代資訊，調節項目為股份基礎給付獎勵及所得稅影響數等，細節請參閱附表補充資訊。

## 市場近況摘要

零售 DIY 低階 SSD 升級市場需求放緩，主因是由於桌上型 PC 市場已於出貨前預先安裝 SSD，終端使用者自行採購 SSD 升級的需求短期放緩（亦即，低階 SSD 的零售市場需求將可能逐漸下降），然長期而言將有機會逐漸轉為大容量 SSD 與高階 SSD DIY 升級需求，尤其在電競、內容創作、生成式 AI 等應用將更為顯著。

群聯電子執行長潘健成表示，雖然零售低階 SSD DIY 升級市場 (Retail) 需求放緩，但是群聯早已布局非零售 (Non-Retail) 與高階 SSD 市場多年，包括近期逐漸看到營收成果的企業級 SSD、生成式 AI 地端微調運算方案 aiDAPTIV+、PC OEM 前裝市場、車載儲存、以及高速訊號傳輸方案 Redriver/Retimer ICs 等，均代表著群聯超前部屬的成果展現。

潘健成接著說明，根據市調機構的資料，生成式 AI 應用與 AI 伺服器的興起，由於 SSD 負責儲存 AI 模型參數以及大量生成資料（包含文字、照片、影片等），可望推升 AI 相關的整體 SSD 需求年增率達 60% 以上，而群聯布局的企業級 SSD 以及 aiDAPTIV+ 正好符合此趨勢需求，未來也都將正面挹注公司營收與獲利。

**【補充資訊】**  
**非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)**  
**財務資訊調節表**

新台幣/百萬元		2024年第二季	2024年第一季	2023年第二季	Q/Q (%)	Y/Y (%)
TIFRS	營業利益	1,997	1,252	717	59.5%	178.5%
	營利率(%)	12.56%	7.57%	7.17%		
調節項目	股份基礎給付酬勞成本	26	1,271	66		
Non-TIFRS	營業利益	2,023	2,523	783	(19.8%)	158.4%
	營利率(%)	12.73%	15.27%	7.82%		

TIFRS	稅後淨利	2,451	2,420	441	1.3%	455.8%
	淨利率(%)	15.42%	14.64%	4.40%		
	基本每股盈餘 (NT\$)	11.97	12.02	2.28		
調節項目	股份基礎給付酬勞成本	26	1,271	66		
	所得稅影響數	(4)	(182)	(19)		
Non-TIFRS	稅後淨利	2,473	3,509	488	(29.5%)	406.8%
	淨利率(%)	15.56%	21.23%	4.88%		
	基本每股盈餘 (NT\$)	12.08	17.43	2.52		

註1：請注意：本表所提供，非以金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)製作之補充財務資訊(簡稱「補充資訊」，為金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)製作之財務報告之補充而非替代資訊，補充資訊之調節項目為股份基礎給付酬勞成本及所得稅影響數等。最終實際盈餘分配將依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)製作之財務報告為準。

註2：若有數值不等，係因計算取位四捨五入造成。

## [群聯公告暨新聞稿訂閱]

如欲獲取群聯新聞稿或其它公告，請訂閱：[群聯投資人關係訊息訂閱](#)

## [關於群聯的關鍵數字]

- 超過 23 年的 NAND 控制晶片暨 NAND 儲存方案整合經驗
- 全球超過 4000 位員工，且 70% 以上為工程師
- 全球近 2000 個 NAND 儲存相關專利
- 透過 5+5 長期發展大戰略，驅動長期千億級營收
- SSD 控制晶片全球市佔率超過 20%
- 車用控制晶片全球市佔率超過 40%
- 群聯與日本 KIOXIA（原 TMC 東芝記憶體）、美光 Micron、威騰 WDC、三星、SK Hynix 等 NAND 原廠，均為長期合作夥伴。
- 超過 70% 營收貢獻度來自於『非消費型』的 NAND 儲存應用市場，包含伺服器、車載系統、嵌入式系統、工控應用、電競主機、生成式 AI 等，讓群聯能在 NAND 產業的波動變化下，依舊能維持相對穩定的營收與獲利。
- 群聯對整體 NAND 產業生態鏈的掌握（包含從上游的 NAND 原廠的雙向合作關係、NAND 控制晶片與儲存模組的供應鏈夥伴、至下游的 NAND 儲存應用客戶等），是群聯所能帶給全球客戶與夥伴的不可取代價值，也是群聯能在 NAND 產業屹立不搖的關鍵優勢。

## [關於群聯電子]

群聯電子 (Phison Electronics Corp.) 長期耕耘於快閃記憶體控制器晶片領域，是全球 NAND 儲存控制晶片 (NAND Controller) 及存儲解決方案 (NAND Storages) 領導廠商。從 IP 技術授權、晶片設計、系統架構解決方案、系統整合至成品，為不同需求的客戶提供最佳的產品與服務。在各項產品類別上，包括 SSD (PCIe/SATA/PATA)、UFS、eMMC、SD 與 USB 介面，皆可提供完整的存儲解決方案。

歡迎拜訪 [群聯網站](#) 或 [群聯 Q&A](#) 以更了解群聯電子。

### 群聯電子發言人

于紹庭 Antonio Yu

TEL: 037-586-896 #10019

Mobile: 0979-105-026

Email: [antonioyu@phison.com](mailto:antonioyu@phison.com)

### 群聯電子代理發言人

呂國鼎 Kuo-Ting Lu

TEL: 037-586-896 #26022

Mobile: 0979-075-330

Email: [kuoting\\_lu@phison.com](mailto:kuoting_lu@phison.com)

## [預測性陳述聲明]

本新聞稿所提供之資訊(除歷史資訊之外)屬於預測性陳述。在此敬告讀者，預測性陳述乃基於群聯之合理認知以及就現狀所作的預估，且將受到各種風險以及不確定因素影響，因此可能造成實際結果和預測性陳述之內容顯著不同。這些風險以及不確定性因素包括但不限於，供給與需求變化、產銷能力、開發成功、及時導入市場、市場競爭、產業循環、客戶財務狀況、匯率浮動、法律訴訟、法令變更、全球經濟變化、自然災害、其他可能會影響群聯業務與營運的不確定因素。鑑於此，讀者請勿倚賴預測性陳述。除法律另有規定外，無論是基於新資訊、未來事件或是其他因素，群聯皆無義務更新預測性陳述。